Searching PAJ Page 1 of 2

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-341664

(43) Date of publication of application: 10.12.1999

(51) Int. CI.

H02G 15/02 H02G 15/184

(21) Application number : 10-139594

(71) Applicant: FURUKAWA ELECTRIC CO LTD: THE

(22) Date of filing:

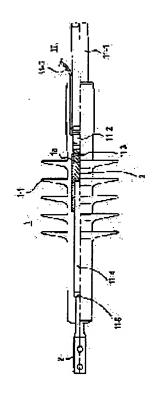
21, 05, 1998

(72) Inventor : SAKURAI YUJI

HANE YOSHINARI

# (54) RUBBER INSULATOR FOR POWER CABLE TERMINATION (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the possibility of occurrence of partial discharge during use and enhance the insulating capability of a power cable terminal, by reducing the size of a gap produced at an end of a cable external semiconductive layer and/or an end of a semiconductive tape. SOLUTION: Horizontal woven hat-shaped fins 1-1 are formed on the surface of the body 1 of a terminal corresponding to an end of a cable external semiconductive layer 11-3 and the vicinity of a semiconductive tape 3. As a result, planar pressure produced at the end of the cable external semiconductive layer 11-3 and the end of the semiconductive tape 3 can be increased, and a gap formed between the cable external semiconductive layer 11-3 and an insulator 11-4 and a gap formed at the end of the semiconductive tape 3 can be reduced. Projections or deeply grooved, woven hatshaped fins may be formed instead of the horizontal woven hat-shaped fins.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19, 09, 2002

[Date of sending the examiner's decision 02.11.2004

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開母号

### 特開平11-341664

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int-CL\*

鐵別紀号

PΙ

H02G 15/02 15/184 H02G 15/02 15/184 A

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出顯器号

(22)出廣日

特顧平10-139594

平成10年(1998) 5月21日

(71)出廢人 000005290

古河蚕気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6巻1号

(72) 宛明者 核井 裕士

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72) 発明者 羽根 良成

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 古

河龟员工奚株式会社内

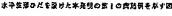
(74)代理人 弁理士 長澤 俊一郎 (外1名)

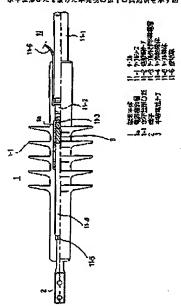
#### (54) 【発明の名称】 電力ケーブル端末処理用ゴム製箱最体

#### (57)【要約】

【課題】 ケーブル外部半導電層鑑部および/または半 導電性テープ端部に生じる空隙を小さくすることによ り、使用中の部分放電発生の可能性を小さくし、電力ケ ーブル鑑末の絶縁性能を向上させること。

【解決手段】 水平笠形ひだ1-1を、ケーブル外部半 導電層 11-3の端部および半導電性テープ 3近傍にあ たる端末本体1の表面上に設ける。これにより、ケーブ ル外部半導電層11-3の端部及び半導電性テープ3の **端部に生じる面圧を増加させることができ、ケーブル外** 部半導電層11-3と絶縁体11-4の間に形成される 空隙、および半導管性テープ3の蟾部に形成される空隙 を小さくすることができる。なお、水平笠形ひだに換 え、凸部を設けたり、深溝笠形ひだを設けてもよい。





特闘平11-341664

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【詰求項 】】 電力ケーブルの鑑末処理に用いられるゴ ム製絶縁体であって、上記ゴム製絶縁体には、深溝笠、 水平笠形ひだもしくは凸部が設けられており、

上記ゴム製絶縁体を電力ケーブルの檔末に取り付けたと き、上記深漢笠、水平笠形ひだの付け彼もしくは凸部 が、ケーブル外部半導電層端部近傍および/またはケー ブル外部半導電層總部近傍に巻き付けられた半導電性テ ープの總部近傍に位置するように配置されていることを 特徴とする電力ケーブル端末処理用ゴム製総縁体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各電力ケーブル、 例えば架橋ボリエチレン維練ピニルシースケーブル(C Vケーブル) やゴムシースケーブル (以下これらを総称 して単にケーブルと称す)の鑑末処理に用いられるゴム 製絶緑体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】ケーブル用端末の組み立ては、通常、次 わち、図3 (a) に示すように、ケーブル11のシース 11-1、遮蔽銅テープ11-2、ケーブル外部半導電 厘11-3、絶縁体11-4を所望の寸法に段割ぎし、 ケーブル導体11-5を露出させる。

【0003】そして遮蔽鋼テープ11-2に接地線11 - 6を取り付けた後、図3(り)に示すように端末本体 1を取り付け、端子2をケーブル導体11-5に圧着等 により接続する。 端末本体1の内面には電界緩和層1 a が設けられており、上記ケーブル外部半導電層11-3 の協部近傍および絶縁体11-4は、上記電界緩和層1 a の部分に位置決めされる。 端末本体が差し込み式の場 台は、 蝗末 本体 1 の内径は段剝ぎされたケーブル 1 1 の 各部の外径より小さく、ケーブル11は端末本体1を押 し広げるようにして挿入される。このため、鑑末本体1 の内面は段剝ぎされたケーブル各部の表面と所定の面圧 で密着する。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記端末に おいては、ケーブル外部半導電層11-3の繼部の空隙 の大きさが、端末の性能に大きく影響を与えることは良 46 く知られている。図4は上記ケーブル外部半導電層11 - 3の纏部近傍を拡大して示した図であり、同図に示す よろに、ケーブル外部半導電圏11-3と絶縁体11-4の間には段差があり、この段差が大きいと、同図のよ うに端末を組み立てたときにこの部分に空隙4が生じ、 使用電圧下でも部分放電が発生する。部分放電が生じる と、その部分が加熱、焼損し、やがては破壊に到る。よ って、この部分の段差を小さくすることが望ましい。 【りり05】そこで、この段差を小さくするため、従来

**端部11-3にこれより薄い半導電性テープ3. 例えば** ACPテープを巻くことがあった。このテープはケーブ ル外部半導電層の厚さ約0.5mmに比べ0.3mmと 薄く、見かけ上、その段差を小さく出来るが、図5 (b) の拡大図に示すように、鑑定本体1を取り付けた とき上記空隙4が完全に無くなる訳ではない。また、こ の部分にシリコーングリースを大量に塗布することも行 われているが、使用中に端末本体材料が吸収してしまう 可能性があるため、使用開始時は問題ないが、長期使用 10 中には不安があった。本発明は上記した問題点を解決す るためになされたものであって、本発明の目的は、ケー ブル外部半導電層鑑部もよび/または半導管性テープ (ACPテープ) 蜷部に生じる空隙を小さくすることに

より、使用中の部分放電発生の可能性を小さくし、電力

ケーブル鑑末の絶縁性能を向上させることである。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明においては、電力ケーブルの缝末処理に用い られるゴム製絶縁体において、上記ゴム製絶縁体を電力 のように行われる。まず、ケーブルを段剝ぎする。すな 20 ケーブルの鑑末に取り付けたとき、ゴム製絶縁体に設け **られた深漂笠、水平笠形ひだの付け很もしくは凸部が、** ケーブル外部半導電層鑑部近傍および/またはケーブル 外部半導電層端部近傍に巻き付けられた半導電性テープ の端部近傍に位置するように配置したものである。

> 【0007】本発明においては、上記のように電力ケー ブルの鑑末処理に用いられるゴム製絶縁体に通常設けら れている深澤笠形ひだや水平笠形ひだの付け根。もしく は凸部を、ケーブル外部半導管層端部および/または半 導電性テープの端部近傍上に配置したので、その部分の 30 面圧を上げることができる。すなわち、深襟笠形ひだや 水平笠形ひだ。もしくは凸部を設けた部分は、ゴムの内 厚が厚いので、ケーブルに触わる圧力が他の部分より大 きくなり、ケーブル外部半導管層鑑部および/または半 導電性テープの端部近傍の面圧を上げることができる。 このため、ケーブル外部半導管層端部および/または半 導電性テープの端部の空隙を小さくすることができ、使 用中における部分放電発生の可能性を小さくし、能縁性 能を向上させることができる。

#### [0008]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施例を示 す図であり、同図の上半分は断面、下半分が外額を示し ている。同図において、1はゴム製の成形体から形成さ れる略円筒状の端末本体であり、端末本体1の内面には 電界緩和層!aが設けられ、鑑末本体1上には複数の水 平笠形ひだ!-1が設けられている。また、鑑末本体! の一端に幾子2が設けられ、他變は開放しており、そこ から所望の寸法に段剥ぎされたケーブル11が挿入され る。11は前記したケーブル、11-1はケーブルシー ス、11-2は遮蔽銅テープ、11-3はケーブル外部 においては、図5 (a)のようにケーブル外部半導電層 50 半導電層、11-4は絶縁体、11-5はケーブル導

特開平11-341664

体。11-6は接地線であり、本真能例においては、上 記ケーブル外部半導管圏上に半導管性チープ(ACPテ ープ) 3が巻き付けられている。

【①①09】本実施例において、上記水平笠形ひだ1-1は、ケーブル外部半導電層11-3の鍵部および半導 電性テープ3近傍にあたる端末本体1の表面上に設ける れている。上記のような位置に水平笠形ひだ1-1を設 けることにより、ケーブル外部半導電層11-3の蟾部 及び半導管性テープ3の端部に生じる面圧を増加させる 11-3と絶縁体11-4の間、および半導電性テープ 3の端部に形成される空隙を小さくすることができ、絶 緑性能を向上させることができる。

【0010】図2は本発明の第2の実施例を示す図であ り、本実施例は、ケーブル外部半導電層11-3の総部 および半導管性テープ3近傍にあたる端末本体1の表面 上に凸部を設けた場合を示している。図2において、前 記図1に示したものと同一のものには同一の符号が付さ れており、本実施例においては、鑑末本体1の表面に、 水平笠形ひだ1-1に加えて凸部1-2が設けられてい。20 る。上記凸部1-2は第1の実施例と同様、ケーブル外 部半導電層11-3の鑑部および半導電性テープ3近傍 にあたる端末本体1の表面上に設けられている。 このた め、第1の実施例と同様、ケーブル外部半導電層11-3と絶縁体11-4の間、および半導電性テープ3の鑑 部に形成される空隙を小さくすることができ、絶縁性能 を向上させることができる。

【0011】なお、上記実施例では、端末本体1上に水 平笠形ひだ、もしくは凸部を設けた場合について説明し たが、端末本体1上に深潜笠形ひだが設けられている場 30 台も、上記と同様、深澤笠の付け根をケーブル外部半導 電層11-3の端部および半導電性デープ3近傍上に位 置させればよい。また、上記実施例では、ケーブル外部 半導電層上に半導電性テープ3を巻き付けた場合につい て説明したが、 半導電性テープ3を巻き付けない場合に は、水平笠形ひだ1-1をケーブル外部半導電層11-3と絶縁体11-4の間に形成される空隙近傍の端末本 体1の表面上に設ければよい。また、これ迄に述べた電 界緩和層18がストレスコーン形状の導電層である場合

でも、同じ効果が得られる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように、本発明において は、ケーブル外部半導電層端部および/または半導電性 テープ造部近傍にあたる端末本体表面に水平笠形ひだや 深溝登形ひだ。もしくは、凸部を設けたので、その部分 の面圧を高くすることができ、ケーブル外部半導電層過 部および/または半導管性テープ (ACPテープ) 蟾部 に生じる空隙を小さくすることができる。このため、使 ことができ、それにより前記したケーブル外部半導管層 10 用中の部分放電発生の可能性を現状より小さくすること ができ、長期使用中の安全性も向上させることができ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】水平笠形ひだを設けた本発明の第1の実施例を 示す図である。

【図2】凸部を設けた本発明の第2の実施例を示す図で

【図3】ケーブルを段剝ぎした状態および鑑末本体を取 り付けた状態を示す図である。

【図4】図3のケーブル半導電層巉部を拡大した図であ

【図5】ケーブルを段剝ぎし半導体テープを巻き付けた 状態および蟾末本体を取り付けた状態を示す図である。 【符号の説明】

1 继末本体

弯界緩和層

1 - 1水平笠形ひだ

1 - 2

幾子

半導電性テープ (ACPテープ)

1.1 ケーブル

11-1 ケーブルシース

11-2 遠蔵銅テープ

11-3 ケーブル外部半導電層

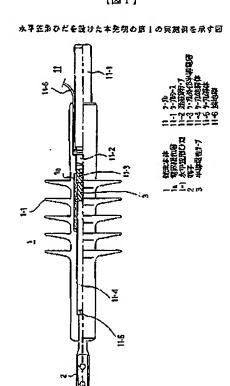
11-4 ケーブル絶縁体

11-5 ケーブル導体

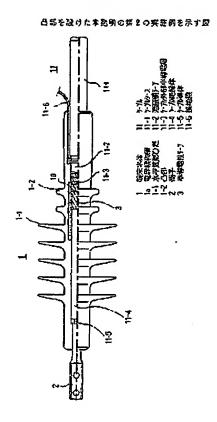
11-6 接地線

(4) 特別平11-341664

[**2**1]

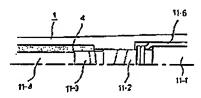


[22]



[図4]

#### 図3のケーブル半導電層総部を拡大した図





(5) 特闘平11-341664

